

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-3

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	详见附件：参会投资者清单。
时间	2026年5月27日-29日
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	投资者关系 林婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司碳化硅衬底材料的业务进展？</p> <p>答：公司以碳化硅衬底为核心，实现从技术突破到规模化供应的关键跨越。公司基于自主研发的碳化硅单晶生长炉以及持续迭代升级的8-12英寸长晶工艺，经过多年的技术攻关，创新晶体生长温场设计及气相原料分布工艺，攻克12英寸碳化硅晶体生长中的温场不均、晶体开裂等核心难题，实现了12英寸超大尺寸晶体生长的技术突破，成功建设12英寸碳化硅衬底加工中试线，并基于下游应用，向产业链客户进行送样验证。同时，积极推进8英寸碳化硅衬底在全球的客户验证，送样客户范围大幅提升，产品验证进展顺利，并成功获取海内外客户的批量订单，订单持续增长。光学级碳化硅材料布局成效显著，8英寸产品工艺稳定并实现规模量产，12英寸光学级碳化硅衬底研发取得突破并小批量生产。</p> <p>2、请问公司碳化硅材料的产能布局进展？</p> <p>答：晶盛机电子公司浙江晶瑞电子材料有限公司抢抓战略发展机遇，全面加速年产60万片8英寸SiC衬底项目投产，并启动建设新一期的基础设施，迎接未来AI、AR等新兴产业爆发式需求的到来。</p>

本次扩产项目实现无人化自动运行和数字化管控，保证车规级 SiC 晶片的质量稳定可靠性和全线可追溯性，建设成为行业领先的全自动智能工厂。同时，同步建设的马来西亚 8 英寸碳化硅衬底工厂预计在 2026 年底通线投产，为全球客户提供多元化的供应保障。

3、请问公司半导体装备业务进展？

答：公司依托半导体装备国产替代的行业发展趋势和机遇，积极推进半导体装备的市场推广。

在集成电路装备领域，积极推进 12 英寸干进干出边抛机、12 英寸双面减薄机等新产品的客户验证；成功开发应用于先进封装的超快紫外激光开槽设备，填补国内高端紫外激光开槽技术领域的空白，实现国产替代。发布方形硅片全流程解决方案，为客户提供效率更高、综合成本更优的一站式设备解决方案。公司自主研发的 12 英寸常压硅外延设备实现小批量销售，其电阻率、厚度均匀性、外延层缺陷密度、生产效率以及工艺重复性等关键指标达到国际先进水平。12 英寸减压外延生长设备顺利实现销售出货，并取得重要客户复购，在先进制程、特色硅光工艺上均取得突破。设备采用单温区、多温区闭环控温模式，结合多真空区间精准控压技术，确保外延生长过程的高度稳定性，其独特的扁平腔体结构和多口分流系统设计，能够显著提升外延层的膜厚均匀性和掺杂均匀性，满足先进制程的高标准要求。

在化合物半导体装备领域，公司紧抓碳化硅产业链向 8 英寸切换的行业发展趋势，充分发挥在碳化硅产业链装备的核心技术优势，加强 8-12 英寸碳化硅外延设备以及减薄设备的市场推广，顺利取得客户订单；积极推进碳化硅氧化炉、激活炉以及离子注入等设备的客户验证，相关设备的验证进展顺利，为规模化量产奠定坚实基础。

在新能源光伏装备领域，公司持续加强研发技术创新，在产品技术和工艺、自动化和智能化以及先进制造模式等领域持续进行创新，聚焦 TOPCon 提效与 BC 技术创新，持续完善金属腔、管式、

板式三大平台设备体系，积极推进 EPD、LPCVD、PECVD、PVD 以及 ALD 等设备的市场推广和客户验证，EPD 设备持续强化行业领先的技术和规模优势，在推动产业创新的同时，助力公司高质量发展。

4、请问公司用于芯片制造的薄膜沉积设备业务进展？

答：近日，晶盛机电下属公司浙江求是创芯半导体设备有限公司多台先进制程核心薄膜沉积设备相继成功交付国内头部客户。此次交付不仅彰显了求是创芯在高端半导体装备领域的技术实力与量产能力，更标志着公司集成电路设备在 12 寸外延、原子层沉积等关键工艺环节迈入行业领先水平。本次交付的 12 英寸减压外延生长设备聚焦先进逻辑与特色硅光器件两大核心领域，依托精准温场流程控制技术，实现高精度硅基薄膜沉积工艺，具备稳定性强、均匀性优异、缺陷可控等技术优势，能够全面满足硅光器件、先进逻辑、高端存储芯片的外延工艺需求，深度适配国产化先进晶圆制造工艺。

5、请问公司半导体零部件的进展？

答：子公司晶鸿精密坚持以核心零部件国产化为目标，不断强化精密加工、特种焊接、组装测试、半导体级表面处理等核心制造能力，持续加强关键零部件的研发攻关和产业化建设，产品质量持续提升，产品品类日益丰富。强化零部件产品的市场拓展，聚焦客户需求，构建研发、制造、服务一体化解决方案，为客户提供高品质、高效率的产品和服务，提升半导体产业链关键零部件的配套供应和服务能力，公司不断拓展真空腔体、精密传动主轴、游星片、陶瓷盘以及其他高精度零部件等系列产品的客户群体，推动市场规模持续提升。

6、公司蓝宝石、氮化硅陶瓷等材料的进展情况？

答：蓝宝石材料受益于 LED 二次替换、Mini/Micro LED 新应用拓展及消费电子复苏，实现同比稳健增长。氮化硅陶瓷材料实现

	<p>重大突破，成功突破了关键流延成型、精密温场控制等全产业链核心技术，首条氮化硅陶瓷基板产线正式通线量产，产品微观结构均匀性、热导率等核心指标对标国际顶尖水平，成功打破国外企业垄断，为新能源汽车、高端装备等领域提供关键材料支撑，降低下游产业进口依赖度。</p> <p>7、请问公司半导体耗材的进展？</p> <p>答：公司石英坩埚业务已实现技术与规模的双重领先，可提供全规格、高品质的石英坩埚产品，广泛覆盖半导体及光伏领域应用；其中半导体石英坩埚成功突破海外技术垄断，实现核心环节国产化替代，光伏石英坩埚市占率持续领跑并稳步提升，为双赛道协同发展奠定坚实基础。同时，公司积极延伸布局石英制品等关键辅材耗材，相关产品顺利通过客户验证并进入规模化量产阶段。</p>
附件清单（如有）	参会投资者清单
日期	2026年5月27日-29日

参会投资者清单

序号	公司
1	南方基金
2	华商基金
3	聚鸣投资
4	野村证券
5	国海证券
6	华创证券
7	西南证券